



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2025-001

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	民生证券李哲、周晓萌、唐梦涵；易方达李凌霄；博时基金何坤、曾鹏；长江证券倪蕤、王泽罡、孟星；中金基金汪洋、李亚寅；汇添富马磊；嘉实基金孟丽婷、赖礼辉、曲海峰、吴悠；银华基金方建；华泰证券吕兰兰、于可熠；中信证券刘琦；南方基金郑晓曦；方正证券徐凡；申万宏源刘建伟；中泰证券冯光亮、谢校辉；东方证券薛宏伟；景顺长城程振宇；华夏久盈桑永亮；光大证券于文龙；东方基金严凯；国泰海通肖隽翀、黄龙；天风资管范伊歌；东吴证券周尔双、李文意、谈沂鑫；泰康资产张耀伟、熊超楠；信达证券莫文字；中邮证券翟一梦；浙商证券褚旭、厉秋迪、许运凯、刘村阳；华创证券丁祎；华安证券徒月婷；国信证券王艺熹、连欣然；华源证券葛星甫；西部机械牛先智；瑞银证券俞佳、赖咏惟、丛悦；柏治资本薛翌；安信证券胡园园、方彬；汇丰晋信陈平；华福机械卢大炜；兴业基金廖欢欢；尚正基金昌思遥；北京星石资管徐星宇；丰琰资产孙啸；中信保诚基金孙浩中；平安银行刘颖飞；德邦基金史彬；首创机械曲小溪；华安基金胡宜斌；青骊资管范彬泰；花旗银行王俊凯；山西机械杨晶晶；博衍基金卢湛；农银汇理魏刚；鼎锋资管李湧；国源信达资管王彦；天治基金朱奕；太平资管窦萍华；东财基金李惠；圆信永丰马红丽；太平养老陆坚；东兴证券张胡学；长盛基金许利天；农银人寿郝贇川；上海同犇资管林烈雄；世纪证券陈峰；建



	信保险彭永锋；华夏基金何竞舟；西部利得基金杨新；甬兴机械凌展翔；金鹰基金金达莱；雪石资管高云志等 249 余人（排名不分先后）
时间	2025 年 4 月 24 日
地点	武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
上市公司接待人员姓名	副总经理、显示事业群总经理、新能源事业群总经理：刘荣华先生 副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 财务负责人：游丽娟女士 上海精测投融资总监：李国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司 2024 年、2025 年第一季度主要经营情况介绍。</p> <p>A：2024 年，公司实现营业收入 256,507.30 万元，同比增长 5.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,759.85 万元，同比下降 165.02%；报告期末公司总资产为 1,007,630.68 万元，较期初增长 9.27%；归属于上市公司股东的净资产为 346,381.68 万元，较期初减少 6.52%。公司 2024 年研发投入 73,061.77 万元，较上年同期增长 10.78%（其中半导体检测领域研发投入 35,797.66 万元，较上年增长 32.76%）。</p> <p>2025 年第一季度，公司继续加大战略研发投入，不断优化产品和客户构成，强化产品升级并加强研发创新，各项业务均取得了较大的突破和进展。本报告期公司实现营业收入 68,940.20 万元，较上年同比增长 64.92%；实现归属上市公司股东的净利润 3,759.66 万元，较上年同比增长 336.06%。报告期内公司研发投入 15,179.11 万元，较去年同期增长 11.40%（半导体检测领域研发投入 7,636.31 万元，较上年同期增长 32.31%；显示检测领域研发投入 6,238.71 万元，较上年同期下降 1.94%；新能源领域研发投入 1,304.09 万元，较上年同期下降 12.56%）。</p> <p>Q2：公司各个板块在手订单情况。</p> <p>A：现阶段，公司半导体领域订单主要来源于前道量检测领</p>



域,前道量检测领域订单占半导体领域订单九成以上。截至《2024 年年度报告》披露日,公司取得在手订单金额总计约 28.44 亿元,其中显示领域在手订单约 7.64 亿元、半导体领域在手订单约 16.68 亿元、新能源领域在手订单约 4.12 亿元,公司半导体业务已成为公司经营业绩的重要支撑。

Q3: 2024 年公司研发投入情况如何?

A: 报告期内,公司继续保持研发投入强度,研发投入 73,061.77 万元,较上年同期增长 10.78%,占营业收入 28.48%。其中,显示检测领域研发投入 31,528.71 万元,较上年增长 4.23%;半导体检测领域研发投入 35,797.66 万元,较上年增长 32.76%;新能源领域研发投入 5,735.39 万元,较上年下降 34.38%。

随着研发投入不断向经营成果进行转化,将对未来公司进一步提升核心竞争力、巩固行业领先地位起到至关重要的作用。未来公司将保持研发投入强度,通过开放创新与资源整合,在平板显示领域巩固已有技术优势,加大新型显示的研究开发力度,积极向上下游领域进行延展,保持竞争力;继续加大在半导体检测设备上的研发投入,持续孵化新技术、新产品,半导体检测设备的订单金额、销售收入持续增长,成为了公司新的业绩增长点,未来,通过持续的研发投入,半导体检测业务预计将成为公司业绩增长的重要引擎。

Q4: 公司毛利率情况如何?

A: 2024 年,受全球政治经济局势动荡、宏观经济复苏趋缓以及行业周期性等多方面不利因素的影响,市场需求较为疲软,公司显示、新能源领域面临较大的挑战和压力,为了巩固公司市场地位,公司根据市场情况下调了部分显示领域的产品价格,积极参与竞争,导致公司显示领域毛利率相较于去年同期有一定幅度下降,显示领域的净利润出现较大幅度下滑。在新能源领域,报告期内营业收入和毛利率下滑明显,报告期亏损约为 8,900 万



元。2024 年度，公司显示领域毛利率 38.36%，相较于去年同期下降 9.02%；半导体领域毛利率 45.75%，相较于去年同期下降 6.18%左右；新能源领域毛利率 30.81%，相较于去年同期下降 4.54%左右。2025 年第一季度，公司不断优化内部管理水平，持续提升精益生产管理能力和加强成本控制，整体毛利率得到提升。

Q5：公司半导体量检测领域发展现状如何？

A：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，逐步形成在半导体检测前道制程、先进封装和后道检测的全领域量检测技术产品布局。公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），老化（Burn-In）产品线在国内一线客户实现批量重复订单、CP（Chip Probe，晶片探测）/FT（Final Test，最终测试，即出厂测试）产品线相关产品已取得相应订单并完成交付。在晶圆外观检测设备领域，公司于 2019 年开始晶圆级产品的立项，现已成功推出 W1200 系列与 WST1200 系列产品并交付封测头部客户。此外，公司自主研发的探针卡产品系列产品也已实现量产。

公司子公司上海精测主要聚焦半导体前道量检测设备领域，掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、电学测试等关键核心技术，致力于半导体前道量测检测设备的研发及生产，设备广泛应用于硅片加工、晶圆制造、科研实验室、第三代半导体四大领域。公司膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备核心产品均处于国内行业领先地位，竞争优势明显。其中膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备已取得国内先进制程重复性订单；半导体硅片应力测量设备验证通过且已取得国内多家头部客户重复批量性订单；明场光学缺陷检测设备已取得多台正式订单，其中先进制程明场缺陷检测设备报告期内已正式交付客户；有图形暗场缺陷检测设备等其他储备的产品目前正处于研



发、认证以及拓展的过程中。随着公司技术水平的不断提高、产品成熟度以及市场对公司产品的认可度不断提升，公司半导体检测业务开拓迅速，订单以及销售收入持续快速增长。

报告期内公司在整个半导体板块实现销售收入 76,794.21 万元，较上年同期增长 94.65%，占公司整体营业收入的 29.94%；截至《2024 年年度报告》披露日，公司在半导体领域在手订单约 16.68 亿元，占公司整体订单 58.65%。半导体领域已成为公司经营业绩的核心支撑。

Q6：公司显示检测领域发展现状如何？

A：2024 年，受全球政治经济局势动荡、宏观经济复苏趋缓、下游消费电子市场需求阶段性波动、市场竞争加剧、成本上涨等不利因素制约，市场需求较为疲软，消费电子行业景气度仍处于低位回升阶段，公司显示领域面临较大的挑战和压力。为了巩固公司市场地位，公司根据市场情况下调了部分显示领域的产品价格，积极参与竞争，报告期内公司显示领域毛利率 38.36%，相较于去年同期下降 9.02%，显示领域的净利润同步出现较大幅度下滑。报告期内，公司在显示领域总体经营情况平稳有序，显示领域实现销售收入 159,078.09 万元，相较于去年同期下降 8.98%。截至《2024 年年度报告》披露日，公司在显示领域在手订单约 7.64 亿元。

2024 年，报告期内公司在新型显示以及智能和精密光学仪器领域取得明显进展。公司在智能和精密光学仪器领域进一步探索、深化、整合显示颜色测量技术、高速数据处理技术和光电设计等核心技术和能力的同时，构建全信息化的运营管理机制、信息化自动化生产制造体系，为后续的软件系统化、硬件模块化以及该领域的快速发展奠定了坚实的基础。公司在智能和精密光学仪器领域，主力产品色彩分析仪、单点光谱仪、光谱共聚焦仪、成像式闪烁频率测仪、成像式亮度色度仪、AR/VR 测量仪等核心产品打破国外垄断，陆续取得研发、产品突破，获得了国内外核



心客户重复批量订单，现阶段已实现较大规模的销售，未来将对显示领域的快速发展提供重要的支撑。

2024 年，公司聚焦新型显示产业革命性机遇，在 AR/VR 赛道实现全产业链深度布局，与全球 AR/VR 行业龙头达成战略协同，构建起覆盖“核心器件-模组-整机”的全制程检测解决方案。在 VR 领域，公司依托自主知识产权的光学检测系统，成功斩获全球 TOP 客户 Micro OLED 微显示及 Pancake 光学模组全流程检测设备独家订单；在 AR 领域，公司在 Display Engine 光引擎、Eyepiece 目镜模组及 FATP 整机组装制程检测环节保持技术代差优势，持续收获重复订单。不仅如此，公司积极探寻新的合作增长点，不断拓展合作边界，正在与海外头部客户基于 Waveguide 光波导检测需求的项目合作，为公司未来业务增长注入强劲动力。这一系列丰硕的合作成果，进一步稳固了公司在头显检测设备领域的技术领先地位。

Q7：公司新能源设备领域发展现状如何？

A：2024 年，受锂离子电池市场需求增速放缓，国内新能源行业呈现阶段性供需失衡的严峻环境下，锂电池装备制造行业市场竞争加剧、电池厂商验收周期延长等因素影响，公司在新能源领域营业收入同比有所下滑，主要产品毛利率下降。

报告期内新能源领域研发投入 5,735.39 万元，较上年下降 34.38%。受收入结构变动、市场竞争加剧、动力锂电设备技术工艺尚处于磨合期等因素影响，客户整体验收节奏放缓。报告期内公司在新能源领域实现销售收入 16,700.37 万元，较上年同比下降 30.71%。截至《2024 年年度报告》披露日，公司在新能源领域在手订单约 4.12 亿元。

Q8：公司明场光学缺陷检测设备采用什么技术路线？目前进展情况如何？

A：公司的明场光学缺陷检测设备采用国际主流的多光谱技术路径。公司顺应半导体市场发展趋势，针对下游晶圆制造企业



	<p>半导体制造工艺节点的升级需求对公司半导体检测设备进行技术迭代，报告期内公司进一步加大了对先进制程领域（14nm 及以下）的研发投入，公司 14nm 先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备报告期内已正式交付客户。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 24 日